

证券代码：300480

证券简称：光力科技

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260210

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	中信资管：张力琦、李旭峰；华夏未来资产：丁鑫；西部证券：李华丰；泰康资产：段中喆；上海常春藤基金。
时间	2026年2月10日
地点	公司郑州航空港厂区2号楼会议室、线上交流（电话会议）
上市公司接待人员姓名	总经理、董事：胡延艳 证券事务代表：关平丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司管理层简要介绍公司情况，并与投资者就公司半导体封测装备业务、物联网安全生产监控装备业务的经营情况等问题进行沟通交流，主要交流内容如下：</p> <p>1、公司半导体设备产能扩产是基于什么考虑？二期项目产能规划有多少？预计什么时候完工？</p> <p>答：感谢您的关注！2025年7月以来，随着客户提货速度的提升以及公司机械划切设备在客户端得到广泛认可，公司国产半导体封测设备已进入满产状态，新增订单也在持续增加。为了紧抓行业发展机遇，更好地满足客户未来的订单交付需求，公司正在全力推进航空港厂区二期项目的建设；二期项目预计于2027年一季度全部建成投产，项目全部投产后，新增产能将是现有产能的三倍以上。</p> <p>2、公司半导体业务的主要客户有哪些，客户主要是什么结构？</p> <p>答：公司半导体业务的客户主要为IDM厂商和OSAT厂商，公司国产机械划片机已得到国内头部封测厂商的批量复购；目前大客户订单占国内半导体业务新增订单的一半左右。</p>

3、公司半导体业务毛利率后续是否会提升？

答：2024 年，公司半导体业务毛利率超 40%，随着公司 8230CF、82WT 等高端定制化设备销售占比逐步提升、公司自研核心零部件的逐步导入应用以及半导体设备产能利用率的上升，公司整体毛利率将会进一步提升。

4、以色列子公司和英国子公司的主要服务区域，产能如果受限的话有什么举措？

答：以色列 ADT 和英国 LP 在行业内具有数十年的经验积累和品牌认可度，积累了大量的行业经验、专业技术和客户资源，利用 ADT 和 LP 的品牌能快速切入下游企业；公司采取国内、国外“双循环”的全球化生产营销模式，以色列子公司 ADT 和英国子公司 LP 均保留了其产销能力，以更好的满足海外客户的需求；公司位于郑州航空港区的生产基地主要服务于国内和东南亚地区的客户需求，同时还可以为国外子公司提供生产协同和供应链支持，以快速响应海外客户需求。

5、公司半导体设备与同行业国际巨头相比表现如何，还有哪些差距？

答：公司半导体机械划切设备已经具有与国际头部对标型号相媲美的切割品质和切割效率，已经进入头部封测企业并形成批量供货。公司根据客户需求开发的高端机械划切设备也实现了批量供货；公司研发生产的激光开槽机、研磨机已进入到客户端进行验证，产品布局日趋完整。公司产品的市场占有率与国际巨头相比还有较大差距，成长空间还很大。

6、公司耗材产品进展情况？

答：在耗材方面，公司研发、生产的产品有软刀、硬刀、法兰、磨刀石等，可广泛应用于半导体封装加工；子公司以色列 ADT 软刀经过几十年的技术迭代和应用积累，性能稳定可靠，是业内少有可按照客户需求提供定制刀片的企业，客户认知度较高；国产化软刀已有型号实现批量供货，硬刀产品目前正在客户端验证。

7、在半导体划切领域，激光划片机和机械划片机之间是什么关系？

	<p>答：激光切割和机械切割在不同的材料和工艺场景中有各自的优势，两者主要是互补关系。公司在两种技术上都有相应的国产化设备，在机械划切领域，公司有 20 余种型号，可广泛应用于各种集成电路和电子元器件的划切工艺中，并可根据客户不同场景的划切需求提供定制化的解决方案；在激光划切领域，公司 12 英寸激光开槽机正在客户端验证中，公司也在加紧推进 8 英寸激光隐切机的研发进度。</p> <p>8、公司核心零部件会对外销售吗，其进展如何？</p> <p>答：公司的空气主轴等核心零部件在实现自主供应的同时也为其他半导体和泛半导体设备客户提供产品。除公司内部使用外，目前已经在硅片生产、光学检测、汽车喷漆等多个应用领域向客户批量供货。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 2 月 10 日